

目錄

CONTENTS

2014年3月號 No.224

市場 | 觀察 | 分析

- 37 廠商熱訊
- 53 低溫多晶矽面板成手機面板主流
- 53 IBM加碼雲端運算服務
- 54 辰鴻布局中低階觸控面板
- 54 威盛嵌入式CPU獲奇異大單
- 55 友達率先成功量產6吋WQHD面板
- 55 台灣封測廠積極布局記憶體封測
- 56 台灣3D晶片技術領先全球



半導體與光電製程設備專輯

Semiconductor & Optoelectronic Processing Equipment

半導體與光電製程設備 · 謝嘉民 主編

- 57 半導體與光電製程設備專輯前言
謝嘉民
- 58 積層型可三維堆疊鳍式及超薄通道電晶體
楊智超、黃文賢、謝東穎、謝嘉民
- 72 直通矽穿孔技術於三維積體電路之應用趨勢與製程介紹
劉建惟
- 86 低溫微波退火應用於高介電薄膜/金屬閘極電晶體
蔡博安、陳政耀、賴瓊惠、羅志偉、李耀仁
- 97 具可調變臨界電壓之雙金屬閘奈米結晶矽電晶體
邱宥浦、謝嘉民、楊智超、黃文賢、高郁聰、潘扶民
- 112 應用氧化鋁/氮化矽堆疊式電荷儲存層改進無接面式快閃記憶體元件的抹除速度
諶俊元、張廖貴術、葉宗浩、王天戈

CONTENTS



The Mark

專 欄

主被動元件

- 120** 用於醫學檢測之微波成像系統的關鍵技術與功效發展

藍祥文、洪政源、翁敏航、張守進

專 題

電子測試

- 140** X電容、共差模電感、磁環對高頻電磁干擾功率輻射

抑制性能研究

林昆平

感測器

- 152** 智慧型溫控直流風扇

蘇士哲

能源技術

- 162** 場發射器應用之石墨烯

黃家宏、馬寧元、朱繼文、王俊傑、魏嘉民、劉世鈞

技術櫥窗

LED

- 170** 低於35W的LED應用中的功率調節：哪種方法最有效？

Alexander Craig

人生偶拾

- 174** 別忘了少子化是天大的事

黃博治

PCB技術小百科

- 176** 印刷電路板之電子零件組裝

翁敏航

本刊圖文未經同意，不得轉載或公開傳送！

社內消息

廣告部

- 19 廣告索引

發行部

- 111 曰經BP社雜誌訂閱消息

- 179 劃撥單

編輯部

- 20 讀者意見調查表

- 71 2014年4月專輯主題說明

- 84 2014年4月專輯主題說明

- 85 2014年5、6月專輯主題說明

- 119 2014年7月專輯主題說明

- 178 投稿須知

直

一 趕



各種引動器

THK